

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b1) 高性能コンピューティング向け実装技術	T S M C ジャパン 3 D I C 研究開発センター株式会社
2	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b2) エッジコンピューティング向け実装技術	先端システム技術研究組合
3	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b2) エッジコンピューティング向け実装技術	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

以上